

# 中華民國工商協進會 第 368 場工商講座

## 全球布局下的企業軟硬整合與供應鏈再造

近年來，隨著美中科技競爭持續升溫、地緣政治風險加劇，以及人工智慧等新興科技快速發展，全球產業版圖正加速重組，企業經營環境也面臨前所未有的挑戰與變革。從供應鏈分散佈局、區域化生產，到數位轉型與 AI 應用深化，各國政府與企業均積極調整發展策略，以提升產業韌性與國際競爭力。

在此趨勢下，產業競爭已不再侷限於單一硬體製造或軟體開發能力，而是朝向軟硬整合、系統整合及跨領域協作發展。隨著 AI 應用從雲端運算逐步延伸至終端設備、智慧製造等第一線應用場域，企業若能有效結合硬體製造優勢與軟體創新能力，不僅有助提升產品附加價值，更能開創新的商業模式與市場機會，成為推動產業升級與企業轉型的重要關鍵。

為協助企業掌握 AI 軟硬整合發展趨勢，深入了解全球供應鏈重組下的新商機與挑戰，本會特別邀請資策會產業情報研究所 (MIC) 朱師右組長蒞臨專題演講，分享最新產業發展觀察與市場趨勢分析。誠摯歡迎各界先進踴躍報名參加。

時間：115 年 7 月 27 日(星期一) 14:00~16:00

地點：台北國際會議中心 201BC 會議室(台北市信義路 5 段 1 號)

時間	內容	主持人/主講人
14:00~14:10	主辦單位致詞	中華民國工商協進會 邱一徹 秘書長
14:10~15:45	全球布局下的企業軟硬整合與供應鏈再造	資策會產業情報研究所 朱師右 組長
15:45~16:00	Q & A 雙向交流	中華民國工商協進會 邱一徹 秘書長 資策會產業情報研究所 朱師右 組長

### 報名表

公司名稱：		地址：	
姓名	職稱	聯絡電話	E-mail

備註：本場講座免收費用，有意參加者請於 7 月 23 日(星期四)前填妥本報名表，傳真至 02-2707-0977；也可直接點擊網址 <https://cnaic.org/tw/news/d32c9d> 或掃描右下 QR-code 至活動頁面，線上完成報名。有疑問可撥 02-2707-0111，轉分機 140 高長逸專員詢問。(本會保有活動報名最終審核之權利；若舉辦當日遇天然災害停止上班上課，本活動將停止舉辦)；本會為推動節能減碳，現場不提供瓶水，請自行攜帶環保杯。

